

Mehr Laserpower für höhere Performance Depaneling mit neuem LPKF CuttingMaster 2122 effizienter.

Ansprechpartner:

Cordula Krause-Widjaja
cordula.krause-
widjaja@lpkf.com
Tel. +49 (0)5131 7095-1327
Fax +49 (0)5131 7095-90

LPKF
Laser & Electronics AG
Osteriede 7
D-30827 Garbsen
www.lpkf.com

Vorstand:

Christian Witt
Britta Schulz

Aktie:

Prime Standard
ISIN 0006450000

Abdruck frei, Beleg erbeten

» [Weitere Pressemeldungen](#)

Mit dem Einsatz einer neu entwickelten Laserquelle sorgt LPKF für eine noch höhere Performance des bewährten und gefragten Nutzentrenn-Systems LPKF CuttingMaster. Erste Applikationen belegen eine deutlich höhere Schneidgeschwindigkeit und damit einen bis zu 25 % größeren Output. Im Preis-Leitungs-Spektrum ergibt sich für Anwender dadurch eine neue Dimension zur Effizienzsteigerung. Zum Preis einer Fräsmaschine können sich Leiterplattenproduzenten so die vollen Vorteile der Lasertechnologie zunutze machen.

Dank ihrer langjährigen Expertise sowohl in der Lasertechnologie als auch im Nutzentrennen haben die LPKF-Ingenieure eine spezielle Laserquelle entwickelt, die nun im neuesten Mitglied der CuttingMaster-Familie zum Einsatz kommt. Diese sorgt zuverlässig für Präzision und Geschwindigkeit. So wird ein Vergleichsmuster im „FastCut“ in 0,8 mm FR4 mit der bisherigen Maschine in bereits schnellen 7,3 Sekunden durchgeführt; der neue LPKF CuttingMaster 2122 schafft das in nur 5.9 Sekunden. Differenz: knapp 20 %. Beim Schnitt mit der CleanCut Technologie sind es sogar über 20 %. Und das bei gleichem Invest. Auch beim Schneiden von Coverlayern erreicht das neue Lasersystem eine deutliche Verbesserung für das Preis-Leistungsverhältnis. Anwender des LPKF CuttingMaster 2122 können also eine höhere Performance und Wertschöpfung erreichen, die sich vom bisherigen Stand der Technik abhebt. Somit vereint LPKF hier die Vorteile der Lasertechnologie in einem besonders kosteneffizienten System.

Alle Lasersysteme der Serie LPKF CuttingMaster 2000 sind ideal für das Schneiden flexibler, starr-flexibler sowie starrer Leiterplatten - beispielsweise aus FR 4, Polyimid und Keramik - geeignet. Es treten keine mechanischen oder nennenswerten thermischen Belastungen durch den Laserschnitt auf. So lassen sich auch empfindliche Substrate präzise bearbeiten. Ablationsprodukte werden direkt abgesaugt. Die Schneidkanäle sind lediglich einige µm breit, wodurch sich die Fläche des Panels optimal ausnutzen lässt.

Der Bearbeitungsprozess ist beim LPKF CuttingMaster vollständig softwaregesteuert. Die Layoutdateien lassen sich einfach per Mausklick auf die Maschine übertragen – ohne längere Umrüstzeiten oder vorherige aufwändige Werkzeugproduktion. Wechselnde Materialien oder Schneidkonturen werden

durch eine Anpassung der Bearbeitungsparameter und Laserwege direkt berücksichtigt. Die weitgehende Automatisierung des kompakten Systems ermöglicht einen hohen Durchsatz und eine hohe Wiederholgenauigkeit, wobei der Grad der Automatisierung anwendungsspezifisch modular ausgewählt werden kann.

Weitere Informationen:

<https://laser-depaneling.lpkf.com/de/cuttingmaster-2122>



Abbildung 1: Mit dem neuen LPKF CuttingMaster 2122 erhält der Anwender höheren Output durch effektivere Schneidgeschwindigkeit

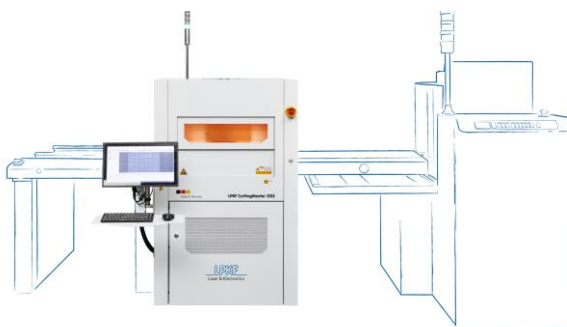


Abbildung 2: Die neue Systemvariante LPKF CuttingMaster 2122 ist auch mit Automationsmodulen erhältlich und passt sich so hervorragend in Fertigungslinien ein.

Über LPKF

Die LPKF Laser & Electronics AG ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Rund 20 Prozent der Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt.